

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2009年12月17日(17.12.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/150929 A1

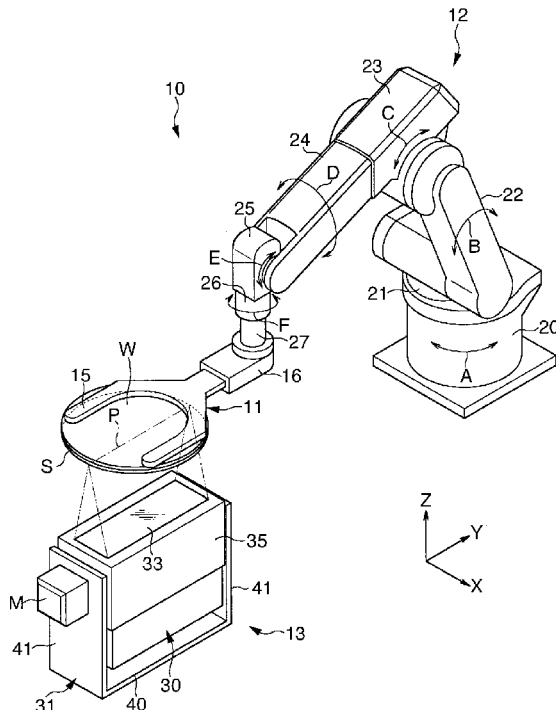
- (51) 国際特許分類:
B01J 19/12 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/059412
- (22) 国際出願日: 2009年5月22日(22.05.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-154209 2008年6月12日(12.06.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林賢治 (KOBAYASHI Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2-3-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧1丁目4番17号 いずみビル8F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

[続葉有]

(54) Title: LIGHT APPLYING DEVICE AND LIGHT APPLYING METHOD

(54) 発明の名称: 光照射装置及び光照射方法

[図1]



(57) Abstract: A light applying device (10) is provided with a support means (11) for supporting a semiconductor wafer (W) which is a body to which ultraviolet light is to be applied and has a circuit forming surface to which an adhesive sheet (S) having an ultraviolet curing adhesive agent is applied, and the light applying device (10) is also provided with an ultraviolet applying means (13) having a focal point axis (P) at a position a predetermined distance from the means and mounted so as to be swingable. The support means is supported by a multi-joint robot (12) and, when the ultraviolet applying means (13) swings, moves the wafer (W) so that an adhesive agent layer surface (SA) of the adhesive sheet (S) is not dislocated from the position of the focal point axis (P).

(57) 要約: 回路形成面に紫外線硬化型の接着剤を有する接着シートSが貼付された半導体ウエハWを被照射体として支持する支持手段11と、所定距離を隔てた位置に焦点軸Pを有するとともに、首振り動作可能に設けられた紫外線照射手段13とを備えて光照射装置10が構成されている。支持手段11は、多関節ロボット12に支持され、紫外線照射手段13が首振り動作したときに、接着シートSの接着剤層面SAが焦点軸Pの位置から外れることがないように、ウエハWを相対的に変位させる。

WO 2009/150929 A1



CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, 添付公開書類:
TG).

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))